

和林微纳：致力成为全球微型精密制造领域领先的系统化方案提供商

——苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾	
苏州和林微纳科技股份有限公司董事长、总经理 苏州和林微纳科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	骆兴顺先生 江晓燕女士
华兴证券有限公司董事总经理、保荐代表人 华兴证券有限公司保荐代表人	朱权炼先生 吴柯佳女士

苏州和林微纳科技股份有限公司
董事长、总经理骆兴顺先生



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持和林微纳的网友：

大家好！
欢迎大家积极参与苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资者网上交流会。今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我代表和林微纳全体员工,向参与今天网上交流的投资者和网友表示热烈的欢迎！向长期以来关心和支持和林微纳的各位朋友表示衷心的感谢！

和林微纳是一家以精微制造为技术核心的国家高新技术企业,公司自2012年在苏州科技城成立以来,一直深耕 MEMS 微机电及芯片测试领域,致力于成为世界级的精微制造企业。

华兴证券有限公司
董事总经理、保荐代表人朱权炼先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！
欢迎各位参加苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐团队和主承销商华兴证券有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者,表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

和林微纳主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售,产品主要包含微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。公司业务遍及美国、英国、丹麦、日本、以色列等发达国家,其精微产品广泛应用于助听器、MEMS 麦克风、微型

苏州和林微纳科技股份有限公司
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
江晓燕女士致结束语



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！
苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会已接近尾声,感谢大家对于公司本次发行的热情关注和踊跃提问,同时也非常感谢保荐机构华兴证券及所有为和林微纳发行上市工作作出努力的各个中介机构,非常感谢上证路演中心、中

公司的各类精微零部件产品广泛应用于芯片封测、TWS 耳机、智能手机、助听器等高科技终端产品,业务遍及美国、英国、丹麦、日本、以色列、韩国等 16 个国家。

通过多年参与全球市场,和顶级品牌客户的合作,公司打造了一支能面向国际市场、充满朝气的专业化人才团队,已形成先进的管理和生产运营体系,先后通过 IATF16949、ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001 等品质体系认证。公司在精微模具结构设计、精微零部件冲压成型、微型芯片测试探针的自动化组装及产品设计等技术领域处于世界领先水平,获得发明专利 12 项,实用新型专利 49 项。同时,公司设有江苏省企业技术中心以及苏州市精微声学零组件工程技术研究中心,在 MEMS 和芯片封装测试环节具有一定的行业知名度。

面向未来,和林微纳拟将本次募集资金投入公司现有主营业务项目,以提升公司的研发能力和核心竞争力。秉持“技术为驱动、客户为导向”的经营理念,不断聚焦更多细分市场,通过一站式精微制造解决方案服务更多全球一流品牌客户,全面提升公司综合实力,更好的实现公司价值。

秉持“利他、成长、感恩、创造社会价值”的理念,和林微纳在追求企业和员工成长、投资者回报的同时,积极承担企业的社会责任,积极打造志愿者活动平台,通过企业公益贡献社会。

最后,再次感谢大家的关注,希望大家积极参与、踊跃提问！谢谢大家！

传感器、智能手机镜头、微电子、汽车部件、医疗产品等高科技微型终端产品。公司市场和研发团队紧跟微型制造市场的前沿需求,不断提高微型制造技术,与知名品牌客户共同开发新产品。

截至 2021 年 3 月 1 日,公司已在相关领域内获得了发明专利 12 项、实用新型专利 49 项、外观专利 2 项;核心技术产品在尺寸、加工精度、模具设计、性能指标、可量产性以及环境适用性等方面获得了多家知名终端品牌厂商的认可。

本次发行上市,将是和林微纳发展历史上的一次重要跨越。相信借助资本市场的力量,公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高,公司将具备更强的竞争力和盈利能力,开启发展和林微纳的新征程。

我们非常荣幸地向资本市场推荐这样一家高效、规范、稳定、有活力的公司。相信此次登陆资本市场,和林微纳一定会抓住机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。我们真诚地希望,通过此次沟通,广大投资者能够更加深入、充分地了解企业价值。华兴证券也将一如既往地继续履行保荐职责,做好持续督导和后续服务工作。

最后,再次感谢各位投资者对和林微纳的关注,我在此预祝和林微纳本次网上路演取得圆满成功。谢谢大家！祝大家身体健康、工作顺利！

国证券商为我们提供的交流平台。谢谢你们！
相信大家通过 3 个小时的沟通与交流,各位投资人对公司的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略应该有了更深层次的了解。未来我们将化责任为动力,不断提高精细化管理水平,加强自身实力,创造出更优良的业绩回报大家。对于每一位热心的朋友们给予的建议和想法,公司一定会认真考虑。我们将继续努力奋斗,进一步提升公司经营管理水平,提高公司经营运作的透明度,实现公司业绩持续快速增长,借助资本市场力量,以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

此次和林微纳网上路演活动即将结束,但公司与广大投资者的沟通交流不会结束。我们将会十分重视投资者关系的协调管理工作,欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,为和林微纳的发展提供宝贵的建议。未来公司将继续秉承企业与社会共同发展的原则,推动企业高质量发展,以优良的业绩回报各位投资者、回报社会！

最后,再次感谢各位投资者的关心和支持,祝大家身体健康、一切顺遂！谢谢大家！



经营篇

问:公司的主营业务是什么？

骆兴顺：公司是一家专注于微型精密制造的高新技术企业,主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。公司拥有丰富的微型精密模具设计经验和微型精密金属成型技术、优秀的国际化团队和规模化的生产能力,实现了国内企业在精密电子领域内的突破。

问:公司的主要产品以及主要应用领域有哪些？

骆兴顺：公司的主要产品可分为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件,主要应用于声学传感器（微型麦克风）、压力传感器等 MEMS 传感器;半导体芯片测试探针系列产品主要包括半导体测试探针,主要应用于测试机及探针台等半导体封测设备。

公司产品主要针对中高端电子产品及应用领域,客户主要为国际知名 MEMS 产品、半导体芯片制造厂商以及半导体封测设备及服务供应商。

问:公司目前的客户资源有哪些？

骆兴顺:凭借良好的市场口碑、优秀的产品品质以及多年来对国际市场的开拓,公司积累了优质的客户资源。公司客户中有意法半导体（STMICROELECTRONICS）、英伟达（NVIDIA）、亚德诺半导体（ANALOG DEVICES）、霍尼韦尔（HONEYWELL）、英飞凌（INFINEON）、安靠公司（AMKOR TECHNOLOGY INC）、博世（BOSCH）、楼氏电子（KNOWLES ELECTRONICS）等国际知名 MEMS 设备制造商,也包括歌尔股份等国内上市 MEMS 厂商。大型 MEMS 厂商通常都与知名的终端消费电子、医疗电子品牌厂家有合作关系,得益于公司优质的下游客户资源,公司产品在苹果、华为、三星、小米、OPPO、VIVO 等国内外知名的消费电子品牌产品中均有应用。

问:公司的研发投入和战略性投入情况如何？

骆兴顺：研发投入是公司根本性的战略性投入。报告期内（2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1 月到 6 月,下同）,公司的研发投入分别为 699.19 万元、903.46、1161.12 万元及 613.96 万元,占营业收入的比例分别为 7.51%、7.88%、6.13%及 7.17%,持续的研发投入确保了公司技术和产品的不断升级。

问:公司近年来的经营情况如何？

江晓燕:报告期内,公司实现营业收入分别为 9314.55 万元、11460.94 万元、18946.47 万元和 8563.20 万元,2017 年至 2019 年的年均复合增长率达到了 42.62%;实现扣除非经常性损益后净利润规模为 2493.96 万元、2667.35 万元、5264.32 万元和 2155.43 万元,2017 年至 2019 年的年均复合增长率达到了 45.29%,公司经营情况良好,业绩保持稳定增长。

问:公司毛利主要来源于哪个产品？

江晓燕:公司的主营业务产品中,毛利主要来源于公司生产的精微屏蔽罩产品。报告期内,该类产品实现毛利占公司总毛利的比例约为 70%左右。随着半导体芯片测试探针业务的发展,该 products 毛利贡献比重将逐步提升。

问:公司主营业务毛利率是多少？

江晓燕:报告期内,公司主营业务毛利率分别为 51.47%、45.90%、47.34%及 43.20%。

发展篇

问:公司未来的发展战略是什么？

骆兴顺：公司致力于成为世界级微型精密制造企业,为客户提供微型精密制造系统方案。公司将紧抓智能终端,5G 通信、物联网、医疗大健康的发展趋势,深耕微机电（MEMS）传感器,半导体芯片行业市场,依托自身在微型精密制造领域的技术积累和国际竞争优势,坚持以创新为动力,以国际顶级同行为标杆,以稳定的品质、快速的响应服务和尖端的技术为竞争基

础,以国际知名品牌客户为支撑,以智能制造为方向,走规模化、差异化和相关性多元化相结合的道路,不断提升核心竞争力,致力成为全球微型精密制造领域领先的系统化方案提供商。

问:公司未来 3 年的经营目标是什么？

骆兴顺:在未来 3 年中,公司将以本次发行上市为契机,利用募集资金加大市场投入,进一步渗透各类微机电（MEMS）器件市场,抢占半导体封测产业市场,实现运营管理的智能化和信息化;通过产学研相结合再提升科技创新能力,进一步攻克微型模具环节和芯片测试环节的核心技术难关;通过引进和培养,建立一支理论与实践相结合的国际化人才团队,力争在 3 到 5 年内使公司成为国际微型精密制造（涵盖微型精密模具技术、微型自动化组装等）领域、微机电（MEMS）精密电子零部件领域以及半导体封测设备领域的行业领跑者。

问:未来公司具体的技术研发计划是什么？

骆兴顺:公司将在未来 3 年中进一步加大对于研发的投入,建设研发中心并为之配备先进的研发设备来加强公司的研发能力,并通过与行业内领先的国际知名客户企业合作开发、自主研发以及产学研合作相结合的方式,实现技术创新的突破。在具体实施上,公司将进一步加强对于材料成型特性、模具高精度间隙配合、机电结合等基础理论的研究,丰富现有的相关数据库,夯实自身的理论和技术基础;同时,公司也将紧贴市场,根据客户需求和行业技术发展方向的变化,开发出适用于 5G 通信、物联网等新应用领域的新技术和新产品,实现公司产品在应用领域上的突破和多元化发展。

问:为确保发展计划的实现公司将采取哪些措施？

骆兴顺:公司将通过以下 4 种方式实现公司未来发展计划:1)本次发行股票将为公司实现未来发展计划提供资金支持,公司将认真组织、争取尽快实现募集资金投资项目的顺利实施,促进产品结构优化升级,巩固公司的行业地位。2)公司将持续加大研发投入,重视新工艺和新产品的研发。同时以本次发行为契机,公司将重视引进行业高端人才,尤其是具有国际视野的管理者及高水平的研发人才,为公司的持续发展提供人才队伍保障。3)公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步完善法人治理结构。公司将优化管理流程,改善公司治理,加强风险管控,提升财务管理水平。4)公司将以本次成功发行上市为良机,拓展融资途径,充分利用资本市场平台为公司未来发展提供资金保障,以便更好实现公司的发展规划和目标。

问:公司在技术和生产工艺方面有哪些优势？

骆兴顺:公司始终高度重视核心技术的自主研发,自成立以来持续投入大量资源用于研发和引入新技术和新工艺,并结合下游行业先进技术和产品的发展趋势以及终端产品的应用情况开展对新产品和新技术的研究。持续的自主研发为公司微型模具设计、产品设计、微型精密金属成型以及规模化生产等重要技术领域内获得了一定的技术优势,为公司未来的发展壮大奠定了良好的技术基础。截至 2021 年 3 月 1 日,公司共拥有专利 63 项,其中发明专利 12 项、实用新型专利 49 项、外观专利 2 项。专利范围覆盖精微电子零部件设计、微型模具设计、微型精密金属成型以及批量化生产等各个环节,形成了自身的核心技术并将其应用到公司的各主要产品线中。

目前,公司的加工能力已达到行业先进水平;同时,在高精度加工条件下,公司产能达到了年产 17 亿件的生产规模。近年来公司始终保持高良品率,成功兼顾了产品品质以及规模化生产的要求。

行业篇

问:公司在行业中的竞争地位如何？

骆兴顺:在微机电（MEMS）精微电子零

部件领域,公司通过积极参与国际竞争成功进入国际先进 MEMS 厂商供应链体系并积累了优质的客户资源;在声学传感器领域,公司拥有突出的市场地位和市场份额;在半导体芯片测试探针领域,公司虽然业务开展时间较短,但是相关业务的开展十分迅速,并已经成为众多国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商,是国内同行业中竞争实力较强的企业之一。

问:公司所属细分行业未来的发展趋势是怎样的？

吴柯佳：精微电子零部件和元器件制造行业的下游客户通常为一些大型电子设备制造商或品牌厂商,该类企业通常选择将产品和技术研发、品牌建设和产业链整合作为其业务核心,将相对繁杂的零部件和元器件制造交由专业性更强的精密制造企业完成。由于不同应用领域对零部件和元器件的需求差异较大,使得专注于不同应用领域的精密制造企业在产品和技术方向上也有较大的差异,从而在行业内形成了因下游领域不同而产生的行业壁垒。未来,随着终端产品的数量种类以及应用场景的不断增多,由下游应用领域造成的精密电子零部件和元器件产品差异化需求将进一步扩大,规模不大的单个精密制造企业难以同时应对各种差异化产品之间不同的需求,将根据自身条件和竞争优势选择某个特定的下游行业发展。

问:公司产品下游市场需求如何？

朱权炼:精微电子零部件和元器件以及半导体芯片产品下游应用领域十分广泛,所涉行业包括消费电子、汽车、医疗、通信以及工业制造等,下游行业市场规模十分巨大且市场容量较为稳定。在 MEMS 领域中,我国始终保持对 MEMS 产品的巨大需求;在半导体芯片领域,2019 年,全球芯片消费额达到 4376 亿美元,其中我国芯片进口额达到 3040 亿美元。作为全球最大的电子产品生产和消费国,我国对 MEMS 以及半导体芯片始终保持着较高的市场需求,来自下游行业巨大的市场需求为精微电子零部件行业发展奠定了良好的市场基础。

发行篇

问:请介绍近几年公司股利的分配情况。

江晓燕:2017 年以来,公司共进行了 3 次股利分配:2019 年 4 月 2 日,和林有限召开股东会并作出决议,宣告分配现金股利 800.00 万元;2019 年 7 月 12 日,和林有限召开股东会并作出决议,宣告分配现金股利 800.00 万元;2019 年 10 月 9 日,和林有限召开股东会并作出决议,宣告分配现金股利 989.81 万元。

问:公司适用于哪项上市标准？

吴柯佳:公司本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定。即预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

问:请介绍公司本次发行前后的股本情况。

朱权炼：公司本次发行前总股本为 6000 万股,公司本次拟公开发行股票不超过 2000 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量）,全部为发行新股,不涉及原股东公开发售股份的情形。在不考虑行使超额配售选择权情况下,公司本次发行后总股本不超过 8000 万股,发行完成后公开发行股票股份数占发行后总股本的比例为 25.00%。

问:公司本次募投项目有哪些？

骆兴顺:本次发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投入 3 个项目,分别是微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目、半导体芯片测试探针扩产项目、研发中心建设项目。